

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2026-017

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 743,187,598 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富乐德	股票代码	301297
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	颜华	李海东	
办公地址	安徽省铜陵金桥经济开发区南海路 18 号	安徽省铜陵金桥经济开发区南海路 18 号	
传真	0562-5302388	0562-5302388	
电话	0562-5302388	0562-5302388	
电子信箱	ftsa001@ftvas.com	ftsa001@ftvas.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

上市公司及下属洗净事业部相关子公司是泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，聚焦于半导体和显示面板两大领域，专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务，为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案，已成为国内泛半导体领域设备洗净技术领先的服务企业之一。富乐德全资子公司江苏富乐华半导体科技股份有限公司（及其下属公司）专注于覆铜陶瓷载板领域，其拥有二十多年研发、生产经验，自主掌握多种覆铜陶瓷载板的先进制造工艺，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，位于行业领先地位。

1、精密洗净服务

（1）半导体设备洗净服务

生产过程中，半导体设备部分零部件表面会沉积覆着物或被刻蚀副产物污染，为确保生产功效，定期对相关生产设备进行洗净。集成电路制造过程中的氧化/扩散（扩散炉、氧化炉、外延生长设备）、光刻（溶胶显影设备、涂胶设备）、刻蚀（介质、金属、边缘刻蚀设备）、离子注入、薄膜生长（金属沉淀设备、介质层沉积设备、原子层沉积设备、电镀设备）、机械抛光等设备均系公司洗净服务对象，几乎涵盖集成电路 2/3 工序的生产设备定期维护。

公司的洗净技术与客户制程的进步相辅相成，能够参与到客户的研发及制程的升级换代中，通过提供专业的洗净服务，协助客户制程不断提高情况下，生产设备洗净能够直接或者尽可能快速的国产化，降低客户的洗净服务成本。公司半导体设备清洗服务覆盖了大部分中国大陆地区在运营的 6 英寸、8 英寸、12 英寸的晶圆代工产线，与中芯国际、华力集成、华力微电子等国内行业巨头建立了长期稳定的合作关系。

除了半导体生产厂商，公司还与世界主要半导体设备厂商（泛林集团、应用材料、东京电子）开展了合作。公司对相关的半导体设备零部件均研发并形成了成熟的清洗工艺，并随着半导体生产制程的提升，不断提供相应的洗净服务。

（2）TFT 设备洗净服务

与半导体产品生产类似，TFT 面板生产过程中，其生产设备零部件表面也会被污染，定期对主要生产设备进行洗净也是 TFT 面板制造的必备环节。

公司 TFT 设备洗净服务是为液晶面板制造企业设备提供定期洗净服务，包含 CF（彩色滤色器）部门（Color Filter）的 IT0 Sputter 薄膜沉积设备，Array 部门的 PVD Sputter 薄膜沉积设备、CVD 薄膜沉积设备，干刻（Dry Etch）部门的干刻刻蚀设备等液晶面板制造企业核心设备的洗净服务。

公司 TFT 设备洗净服务覆盖了 G4.5/G5/G5.5/G6/G8.5/G8.6/G10.5 代次的全阶段沉积和刻蚀等设备，涉及设备腔体挡板、玻璃运载装置、Mask 等约 1,500 款零部件产品的清洗服务。

（3）OLED 设备洗净服务

公司 OLED 洗净服务是为 OLED 面板制造企业的易污染主要设备提供定期洗净服务，主要包含蒸镀部门的蒸镀机设备、IMP 部门的离子注入设备等核心设备。

公司 OLED 设备洗净服务覆盖了硅基微显示蒸镀设备及 G4.5/G5.5/G6 代次的蒸镀及离子注入设备，涉及设备腔体挡板、点源坩埚、线源坩埚、Open mask 等约 900 款零部件产品。

2、精密洗净衍生增值服务

(1) 氧化加工服务

氧化加工服务是为半导体和显示面板行业的干刻刻蚀设备零部件提供表面阳极氧化加工处理，以抵抗刻蚀过程中机台刻蚀气体的腐蚀，保护腔体核心部件，减少刻蚀副产物的污染。

公司氧化加工服务覆盖了显示面板 G4.5/G5.5/G6/G8.5/G10.5 代次的干刻设备以及半导体部分干刻设备，涉及设备的腔体挡板、上部电极、下部电极等约 1,200 款零部件。

(2) 陶瓷熔射服务

在半导体和显示面板制造过程中，强烈的等离子冲蚀和化学腐蚀会造成制造设备的性能降低，同时造成设备的频繁维护和产品良率的降低。高纯耐腐蚀陶瓷涂层作为保护层在刻蚀设备中具有广泛的应用，特别是半导体、TFT 行业制程不断提高的过程中，对耐腐蚀涂层的要求越来越高，应用范围也越来越大。

公司陶瓷熔射服务产品包括：半导体刻蚀腔体内衬、钟罩、静电吸盘、气体分配盘等关键零部件，TFT 刻蚀腔体中的陶瓷板、内壁板、上部电极、下部电极等重要零部件，在 PVD、CVD 的腔体中，也有少量的应用。

(3) 半导体设备维修服务

公司报告期内所提供的半导体设备维修服务，主要包括 HS 翻新服务（主要是为 CMP 设备研磨头进行清洗、配件更换维修再生服务）和 ALN 加热器陶瓷部件高精修复业务。

CMP 设备是半导体行业化学机械抛光装置的缩写，其研磨头主要起到固定晶圆硅片的作用，抛光时，晶圆硅片吸附在研磨头下方，旋转的研磨头以一定的压力在旋转的抛光垫上，由亚微米或纳米磨料和化学溶液组成的研磨液在硅片表面和抛光垫之间研磨抛光。随着 CMP 研磨头耗材使用寿命的增加，CMP 的研磨速率、研磨均匀度等参数都会发生变化，故需定时对研磨头的耗材进行更换维修及清洗。

ALN 加热器陶瓷部件高精修复业务：ALN 加热器是半导体芯片制造过程中 CVD 制程内的关键设备，主要用于给 CVD 气体加热。使用过程中晶圆放置在加热器的表面，通过加热器对晶圆进行加热，CVD 气体进入腔体内后，在晶圆表面加热后发生反应形成薄膜沉积在晶圆表面。而 ALN 加热器作为高价值配件使用一段时间就需要进行一定维修才能继续使用。维修的内容主要包括再造加热器表面微米级的轮廓形貌，真空焊接恢复电容电阻，以及陶瓷柱及晶圆承载面的升级和更换。

3、覆铜陶瓷载板的研发、生产和销售

公司全资子公司富乐华专注于覆铜陶瓷载板产品领域，拥有二十多年的研发、生产经验。其自主掌握多种覆铜陶瓷载板的先进制造工艺，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，位于行业领先地位。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），富乐华所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”下的“电子专用材料制造”（C3985），其产品主要包括直接覆铜陶瓷载板产品（DCB）、活性金属钎焊覆铜陶瓷载板产品（AMB）及直接镀铜陶瓷载板产品（DPC）产品，主要客户及应用领域如下：

（1）DCB（Direct Copper Bonding）产品

富乐华公司 DCB 产品采用将铜箔直接高温烧结在陶瓷片表面的工艺，具有优秀的热循环性、高机械强度、高导热率、高绝缘性和大电流载流能力等。陶瓷材料方面，富乐华拥有氧化铝（ Al_2O_3 ）、氮化铝（AlN）及氧化锆增韧氧化铝（ZTA）的 DCB 工艺产品。

DCB 产品的主要客户包括比亚迪、英飞凌、斯达半导、士兰微、富士电机等国内外功率半导体领先企业，终端主要应用于工业控制、家用电器、光伏、风力发电等领域。

（2）AMB（Active Metal Brazing）产品

AMB 工艺系 DCB 工艺的进一步发展。DCB 工艺因铜和陶瓷之间没有粘结材料，在高温服役过程中的结合强度表现难以满足高温、大功率、高散热、高可靠性的封装要求。AMB 工艺则是一种利用含少量活性元素的活性金属材料实现铜箔与瓷片间的焊接工艺，相比 DCB，AMB 产品的结合强度更高，可靠性更好，更适用于连接器或对电流承载大、散热要求高的场景。同时，AMB 产品采用氮化硅（ Si_3N_4 ）瓷片，氮化硅材料由于综合性能突出，采用 AMB 工艺制作的覆铜陶瓷载板在高功率、大温变电力电子器件封装领域发挥重要作用及优势，可满足功率半导体模块小型化、高可靠性等要求，是更适合第三代半导体和新型高压大功率电力电子器件的封装材料，在电动汽车、轨道交通等应用领域具有巨大的市场空间。

AMB 产品主要客户为意法半导体、博格华纳、比亚迪、中车时代、富士电机等行业知名企业，终端主要应用于新能源汽车、动力机车领域。

（3）DPC（Direct Plated Copper）产品

DPC 产品通过磁控溅射、图形电镀实现陶瓷表面金属化，再通过表面处理提高载板抗氧化性和可焊性。DPC 产品具有导热/耐热性好、图形精度高、可垂直互连及热膨胀系数与芯片匹配等诸多特性。相较于其它载板产品，DPC 在线路精度上有明显优势，载板上下表面互联的特性可满足高密度封装的条件。DPC 产品主要应用于激光制冷器，未来在工业激光、车载激光、光通信等高端应用领域拥有广阔的应用前景。

4、公司主要经营模式

公司及下属洗净事业相关子公司是泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，其主要经营模式如下：

（1）盈利模式

公司专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净和衍生服务，并通过不断开发高制程或高世代洗净服务技术、提升洗净服务能力，满足泛半导体行业客户不断提升的洗净服务需求，并获取收入和利润。

公司与客户紧密合作，根据客户需求为其提供定制化的专业洗净服务解决方案。公司一般在客户端配备专业的驻厂服务人员，及时了解客户需求，快速响应和解决反馈问题，并根据需要协助客户安装和管理洗净部件。通过持续的洗净服务，并通过与全球三大半导体设备供应商的合作，公司与主要晶圆代工企业、主要显示面板制造企业建立起了广泛、长期、稳定的业务合作关系。

（2）销售模式

公司下游客户主要为晶圆代工和显示面板制造企业。公司采取多渠道掌握行业发展动态和客户需求，通过展会等形式推介公司品牌、技术实力与服务水平，主要通过商务谈判取得订单。

1) 公司业务获取途径主要分两种：其一，自主接单，即直接与半导体和面板生产厂商合作，为厂商提供设备洗净服务；其二，与原设备厂商合作，为其提供配套服务（如应用材料\泛林集团等），主要系半导体高阶制程生产设备，在原设备厂商需提供的质保期内，半导体生产厂商为避免对设备售后造成不利影响，通常委托原设备厂商提供清洗服务，但原设备厂商在国内一般没有设备洗净服务能力，为降低业务成本，一般会将其外包给国内专业的洗净服务商提供相关服务。

2) 公司业务开展主要为直销模式。

3) 公司的市场开拓策略为：首先，开拓全球泛半导体龙头企业客户，通过品质良好的洗净服务，取得其对公司技术和服务的认可，以树立公司的市场声誉；然后，凭借在行业取得的业绩和声誉，公司持续开拓泛半导体行业新兴区域市场。

4) 在国内泛半导体设备洗净服务市场，部分客户采用招投标方式遴选设备洗净服务供应商，行业内目前通过招投标方式获取订单比例相对较小，但系未来发展的方向。目前，公司主要通过谈判方式取得订单并提供服务。

（3）研发模式

1) 公司以自主研发为主，通过建立多部门协同配合的自主创新机制，逐步形成了科学的研发体系和规范的研发流程；公司亦逐步构建与客户协同研发、共同提高的研发机制，为洗净业务能力提升、不断满足客户需求提供了有力支撑。此外，公司与上海大学合作，培养科研人才，不断提升公司研发水平和能力。

2) 公司研发分为两种情况：需求型研发（生产需求为导向）和前瞻型研发（基于充分的行业前瞻性研究，并结合现有技术及市场需求的调研，完成前瞻性生产工艺的研发）。

（4）采购模式

公司采取与供应商签订年度框架合同并结合需求订单方式开展采购，目前，公司已与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系。

（5）生产和服务模式

1) 公司的业务具有“多品种、小批量”的特点，主要系由于相关设备零部件种类繁多、工艺复杂所致。公司一般在客户处配备专业的驻厂服务人员，及时了解客户需求和信息沟通，并根据需要协助客户进行安装或管理清洗部件。

2) 公司的业务具有“非标准的定制服务”特点，需根据下游客户的装备特点和工艺的差异化需求，进行定制化工艺设计、洗净和加工，不完全类同。

3) 公司主要实行订单式的生产模式，在与客户签订订单并取得客户需洗净被污染设备后，由生产部下达生产计划，根据客户需求进行半导体及显示面板设备洗净，以满足客户差异化交期需求。

公司下属子公司江苏富乐华（及其相关子公司）专注于覆铜陶瓷载板产品领域，其主要经营模式如下：

（1）采购模式

富乐华公司主要采取“按单采购、主要原材料提前备货结合”的模式，即按照客户订单采购材料。富乐华根据客户订单、生产计划，综合考虑原材料价格、产品质量、付款方式、供货能力等因素，经审批后与相关供应商订立采购协议，下达采购订单。对于部分铜、瓷片等主要原材料，在综合考虑供应链稳定、价格波动、生产用料安全等因素，富乐华采取提前备货的策略，保证一定的库存量。

富乐华对供应商执行严格的审核标准，并建立了完善的供应商管理制度，在选择供应商时，综合考虑其在产品质量、产品供应的稳定性、产品报价情况、产品技术支持与服务等方面的综合实力，选择性价比高的供应商。同时在产品的采购过程中对供应商持续进行评价和管理。

（2）生产模式

富乐华采用“以销定产、需求预测相结合”的生产模式，产成品主要根据客户定制需求进行生产，同时根据销售部门获得的客户预测数据，结合产能利用率情况，对于半成品进行备货式生产。对于定制产品，生产管理部根据客户用户订单的产品规格、客户需求交期、交付质量和数量等组织生产，品质部负责对生产流程中的在产品和最终产成品进行检验；对于半成品，生产管理部根据销售部门获得的客户预测数据，结合产能利用率情况，进行提前生产。富乐华紧密跟踪市场及客户的需求，根据实际的应用需求进行产品研发，为客户提供性能优异的产品，与客户建立长期稳定的合作关系。

部分非核心工艺如表面处理等采用委外加工的形式进行生产，富乐华对委外加工产品质量严格管理，报告期内整体金额较小。同时，富乐华不断完善生产工艺，主要产品均已实现全流程自制。

（3）销售模式

报告期内，富乐华通过直销模式向全球多地销售产品。其已建立了较完善的境内外销售网络和服务体系，产品销往中国大陆、欧洲、日本、美国、韩国、新加坡等国家和地区。其凭借良好的业内口碑、领先的产品实力和服务水平积极获取销售订单，并与客户建立长期良好的合作关系。富乐华已建立独立的销售体系，独立负责对外销售的全部环节。凭借在行业内多年积累的良好声誉，其主要通过主动开发、客户引荐等方式获取客户资源。

此外，应部分客户库存管理及响应要求，富乐华采用寄售销售模式，具体流程为：标的公司在收到客户发货通知后，按照客户指令，通知要求在约定的时间内将货物产品运至客户指定仓库指定存放区域，货物入库前，双方对合同货物的

数量、规格、型号、外观包装等进行查验，确认货物数量、规格型号无误、外观无破损。入库后，客户按照实际需求领用货物，并按月根据客户实际领用以及与客户对账、确认的凭据确认销售收入并结算。

（4）研发模式

富乐华以自主研发为主，采用研究院、技术部主导，多部门协同配合的自主创新机制，逐步形成了科学的研发体系和规范的研发流程。其研发项目类型包括需求型研发和前瞻型研发。研发服务对象包括：内部研究开发和对外研发，其中对内研发包括服务于富乐华及富乐德生产、经营需求或未来战略布局而开展的研发项目；对外研发包括承担国家相关项目，以及对外开展研发合作、收取研发费用等多种模式。具体情况如下：

需求型研发：该研发模式以生产需求为导向，对生产过程中涉及的工艺技术难题，由生产部门提出研发要求，主要由技术部组织研发项目论证、设计、实施及验证等阶段管理，确保相关技术难题得以快速解决、并迅速用于生产环节，从而实现工艺及产品质量的提升。

前瞻型研发：基于市场部的市场需求调研，富乐华研究院根据市场发展情况及行业前瞻性判断，结合富乐华现有技术能力制定针对新产品、新工艺和新技术的前瞻性研发计划，并组织相关研发项目的论证、设计、实施验证等阶段管理。

富乐华的研发流程主要包括：研发项目立项、研发项目执行、研发项目结题与验收三个阶段，实行项目组长负责制。

二、报告期内公司所处行业情况

1、精密洗净服务行业

精密洗净服务行业是工业清洗行业的重要分支，通常在环境严格控制的洁净室，按照非常严格的标准进行清洗，对清洗标的清洗后剩余颗粒或其他污染物的容忍度非常低（颗粒尺寸小于 0.3 微米），目前精密洗净服务已成为精密生产设备部件组装前的先决条件，也是制程设备的日常保养和维护的先决条件，精密设备部件洗净的质量将直接影响产品生产良率和生产成本。泛半导体洗净行业发展趋势如下：

市场规模增长：精密洗净业务作为保障半导体设备高效、稳定运行的关键环节，得益于国内半导体制造企业不断加大产能投入，以及对设备精密洗净服务的品质和需求同步提升等因素，市场规模预计将保持增长趋势。

技术创新升级：在清洗技术改进方面，物理清洗和化学清洗技术不断优化，新的清洗工艺和设备不断涌现，以提高清洗效率和质量，降低清洗成本和对环境的影响。在清洗制程进步方面，随着半导体器件集成度提高、芯片工艺节点缩小及器件结构趋于复杂，对洗净精度要求不断提升。

服务拓展延伸：洗净服务企业的业务将由单纯的洗净业务更多地延伸到陶瓷熔射、阳极氧化、维修翻新等附加值较高的服务领域。通过为客户提供包括清洗、检测、维修、翻新等在内的一站式服务，满足客户的多样化需求，提高客户满意度和忠诚度。

公司是国内最早从事精密洗净服务的企业之一，亦系国内最早实现半导体 PVD 洗净工艺量产服务的企业之一。凭借先进的技术、丰富的产品线和稳定的服务质量，公司得到国内主流晶圆代工和显示面板制造企业的普遍认可，取得良好

的市场口碑。是目前中国大陆洗净技术先进、服务范围（洗净标的物品类）广泛的半导体和面板设备洗净服务企业之一，已逐步确立了国内半导体和显示面板设备精密洗净服务领域的领先优势地位。

公司精密洗净服务目前主要集中在中国大陆，国内竞争对手主要如湖州科乘电子科技有限公司、南京弘洁半导体科技有限公司、苏州高芯众科半导体有限公司、江苏凯威特斯半导体科技有限公司等。

2、陶瓷载板行业

随着电动汽车、电力机车以及半导体照明、航空航天、卫星通信等进入高速发展阶段，其电子器件工作电流大、温度高、频率高，为满足器件及电路工作的稳定性，对芯片载体提出了更高的要求。陶瓷载板具有优异的热性能、微波性能、力学性能以及可靠性高等优点，可广泛应用于这些领域。基于陶瓷材料制备的陶瓷载板具有耐高温能力强、绝缘性能好及化学性能以及其较高的气密性，可隔离水汽、氧气和灰尘等特点，为电子器件及电路提供稳定的工作环境，保障其使用寿命。部分陶瓷载板还耐辐射，在航空航天和核工业领域有广阔的应用前景。目前应用于陶瓷载板的材料主要有：氧化铍(BeO)、氧化铝(Al₂O₃)、氮化铝(AlN)、氮化硅(Si₃N₄)和碳化硅(SiC)等。陶瓷载板由陶瓷基片和布线金属层两部分组成，金属布线是通过在陶瓷基片上溅射、蒸发沉积或印刷各种金属材料来制备薄膜和厚膜电路。在电子陶瓷封装中，陶瓷载板除了为电路和芯片提供结构支撑和电气互连，还必须为其提供良好的热处理以确保正常工作。陶瓷载板主要有平面陶瓷载板及多层陶瓷载板。平面陶瓷载板又称为陶瓷电路板，根据不同工艺主要分为薄膜陶瓷载板、厚膜印刷陶瓷载板、陶瓷覆铜载板等。目前，国内常用陶瓷载板材料主要为 Al₂O₃、AlN 和 Si₃N₄。Al₂O₃ 陶瓷载板主要采用 DBC 工艺，AlN 陶瓷载板主要采用 DBC 和 AMB 工艺，Si₃N₄ 陶瓷载板更多采用 AMB 工艺。

公司全资子公司江苏富乐华半导体科技股份有限公司成立于 2018 年 3 月，是专业从事功率半导体覆铜陶瓷载板（AMB、DCB 和 DPC 等）的集研发、制造、销售于一体的先进制造业公司。其自主掌握多种覆铜陶瓷载板的先进制造工艺，在功率半导体覆铜陶瓷载板领域拥有二十多年的研发、生产经验，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商，位于行业领先地位。

从全球市场分布来看，覆铜陶瓷载板市场相对较为集中。富乐华主要竞争对手为罗杰斯、KCC 集团、贺利士、Dowa 等国际材料龙头，国内已有部分掌握陶瓷载板生产技术的企业，如浙江德汇、无锡天杨、南通威斯派尔等，但总体产能与产品性能和行业领先企业存在一定差距。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2025 年末	2024 年末		本年末比上年 末增减	2023 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	6,875,208,537.64	1,809,811,858.88	5,822,672,281.66	18.08%	1,664,224,185.31	5,299,042,405.80
归属于上市公司股东的净资产	5,358,605,183.51	1,511,562,915.18	3,211,821,253.17	66.84%	1,462,132,475.18	3,044,379,081.05
	2025 年	2024 年		本年比上年增 减	2023 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	2,866,526,437.56	780,458,405.25	2,667,482,418.45	7.46%	609,165,018.43	2,277,256,833.15
归属于上市公司股东的净利润	402,753,459.98	108,875,574.22	254,038,867.71	58.54%	93,896,829.85	283,023,958.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,642,189.25	87,443,664.72	87,443,664.72	87.14%	69,814,667.84	69,814,667.84
经营活动产生的现金流量净额	375,127,546.11	196,007,702.85	389,177,482.72	-3.61%	137,076,306.26	350,759,568.35
基本每股收益（元/股）	0.63	0.32	0.45	40.00%	0.28	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.32	0.45	40.00%	0.28	0.51
加权平均净资产收益率	7.83%	7.34%	8.12%	-0.29%	6.74%	9.82%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	737,980,263.93	716,800,566.61	683,560,984.07	728,184,622.95
归属于上市公司股东的净利润	66,255,724.24	48,371,615.84	90,357,962.90	197,768,157.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,218,362.82	26,198,202.63	83,335,556.98	32,890,066.82
经营活动产生的现金流量净额	-11,329,670.07	157,366,998.17	69,852,893.86	159,237,324.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

上述财务指标与公司已披露的季度报告、半年度报告相关财务指标存在的差异系同控合并追溯调整所致。

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,142	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,507	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
上海申和投资有限公司	境内非国有法人	52.67%	391,460,970.00	221,460,970.00	不适用	0.00			
共青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.98%	22,130,480.00	22,130,480.00	不适用	0.00			
上海祖贞企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.69%	20,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	15,372,142.00	15,372,142.00	不适用	0.00			
国投招商投资管理有限公司—先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	11,350,705.00	11,350,705.00	不适用	0.00			
嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	11,290,719.00	11,290,719.00	不适用	0.00			
上海泽祖企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	10,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
杭州伯翰资产管理有限公司—安徽耀安伯翰高科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	7,481,762.00	0.00	不适用	0.00			
矩阵（海南）私募基金管理有限公司—温州矩阵纵横六号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.92%	6,841,554.00	6,841,554.00	不适用	0.00			
宁波申毅投资管理有限公司—嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	5,479,655.00	5,479,655.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海祖贞和上海泽祖同受上海申和控制，上海申和、上海祖贞、上海泽祖为一致行动人。								

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

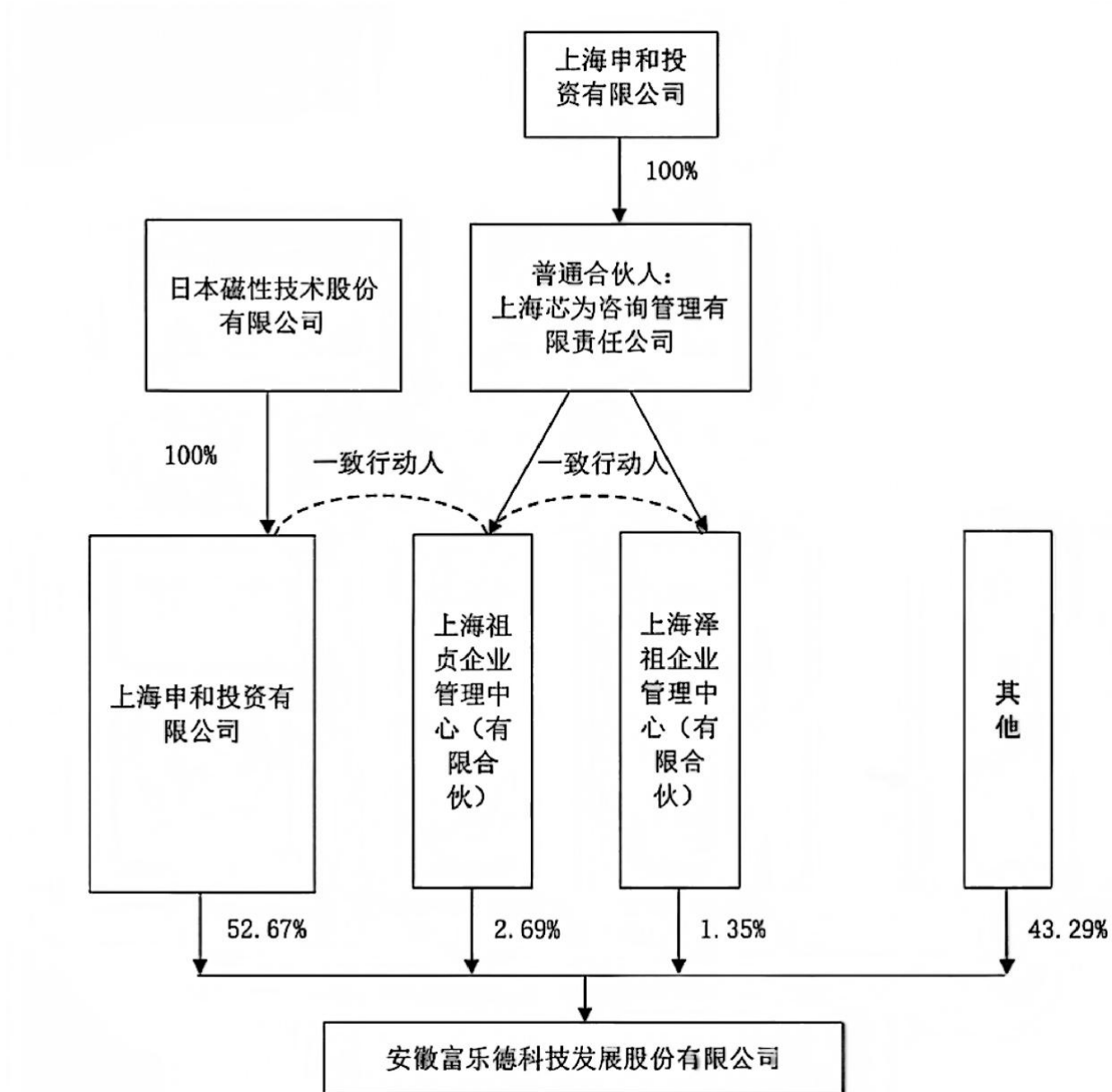
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
富乐德可转换公司债券	富乐定转	124025	2025年07月08日	2029年07月07日	35,990.09	0.01%
报告期内公司债券的付息兑付情况		无				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2025 年	2024 年	本年比上年增减
资产负债率	21.81%	20.72%	1.09%
扣除非经常性损益后净利润	16,364.22	8,744.37	87.14%
EBITDA 全部债务比	185.83%	221.84%	-36.01%
利息保障倍数	53.43	40.24	32.78%

三、重要事项

2025 年度，由于实施重大资产重组，公司完成了对富乐华 100% 股权的收购。重组前，公司主要从事泛半导体领域设备精密洗净服务，重组完成后，公司切入了功率半导体关键材料——覆铜陶瓷载板（DCB/AMB/DPC）领域，形成了“洗净服务 + 半导体材料”双主业并行的格局。由于富乐华的体量远超重组前的富乐德，其并表直接带来了公司收入和利润的大幅增厚，覆铜陶瓷载板业务具体经营数据请见 2025 年年报“第三节 管理层讨论与分析/四、主营业务分析”相关章节。